

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: PROSIDING**

Judul karya ilmiah (paper) : *Thickness And Resistivities Of Cu/ Ni Film Resulted By Electroplating On The Various Electrolyte Temperatur*

Jumlah Penulis : 3 orang

Nama Penulis : *Jumrati Wastha, Moh. Toifur, Azmi Khusnani*

Status Pengusul : Penulis Tunggal/ Penulis pertama/ penulis ke 2 / penulis korespondensi **

Identitas Prosiding : a. Judul Prosiding : The 2019 Conference On Fundamental And Applied Science For Advanced Technology
 b. ISBN/ISSN :
 c. Tahun terbit, tempat pelaksanaan :
 d. Penerbit/organizer : IOP Publishing
 e. Alamat Repository PT/web prosiding : <https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1373/1>
 f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	<i>Internasional</i>	<i>Nasional</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	1,5		1,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4,5		4,0
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	4,5		4,0
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/prosiding (30%)	4,5		4,0
Total = (100%)	15		13,5
Nilai Pengusul	3		2,7

Komentar Peer Review

1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur :

Artikel telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian sebagai artikel internasional

2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan :

Ruang lingkup dan kedalaman artikel cukup & terlihat dari karakteristik yg dilakukan dalam riset.

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi :

Cu' Ni, tetap akan menjadi prospek perhatian para para peneliti. Ilmu aplikasinya pada teknologi sensor.

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit :

Kualitas penerbit telah dibuktikan dg keterlibatan para berbagai kegiatan seminar Internasional

5. Indikasi plagiasi :

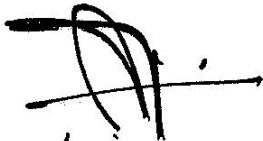
Saya tidak menemukan plagiasi dalam artikel ini

6. Kesesuaian bidang ilmu :

Sesuai dalam bidang Fisika Material

2020

Reviewer 1/2 **



Nama Prof. Ariswanto
NIP/NIY. 195909141988031003
Bidang Ilmu Fisika Material
Jabatan Akademik Guru Besar
Unit Kerja FMIPA UNY

* dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** coret yang tidak perlu

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: PROSIDING**

Judul karya ilmiah (paper) : Thickness And Resistivities Of Cu/ Ni Film Resulted By Electroplating On The Various Electrolyte Temperatur

Jumlah Penulis : 3 orang

Nama Penulis : Jumratul Wusthu, Moh. Toifur, Azmi Khusnani

Status Pengusul : ~~Penulis Tunggal/~~Penulis pertama/penulis ke 2 /~~penulis korespondensi~~ **

Identitas Prosiding : a. Judul Prosiding : The 2019 Conference On Fundamental And Applied Science For Advanced Technology
 b. ISBN/ISSN :
 c. Tahun terbit, tempat pelaksanaan :
 d. Penerbit/organizer : IOP Publishing
 e. Alamat Repository PT/web prosiding : <https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1373/1>
 f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 (beri V pada kategori yang tepat) Prosiding Forum Ilmiah Nasional

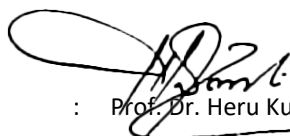
Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	1,5		1,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4,5		4
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	4,5		4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/prosiding (30%)	4,5		4,5
Total = (100%)	15		14
Nilai Pengusul	3		
Nilai Reviewer	Penulis kedua dari tiga penulis = (40%/2) X 14 =		2,8

Komentar Peer Review	<p>1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : Tullisan terdiri atas; Judul, Penulis, Abstrak, , Introduction, Research Methods, Results and discussion, Conclusion, Acknowledgment, References.</p> <p>2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : Tulisan membahas ketebalan dan resistivitas lapisan tipis Cu/Ni yang dibuat electroplating dengan memvariasi temperatur elektrolit. Ada stu gambar analisis dan tabel rangkuman. Pembahasan dibandingkan dengan hasil dari refrensi [13,14]</p> <p>3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : Ada 14 refrensi. Paling baru 2018.</p> <p>4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit : Makalah disajikan pada The 2019 Conference On Fundamental And AppliedScience For Applied Science For Advanced Technology. Proceeding diterbitkan oleh Journal of Physics Conference Series</p> <p>5. Indikasi plagiasi : -</p> <p>6. Kesesuaian bidang ilmu : Tulisan berkaitan dengan Fisika, sesuai dengan bidang ilmu penulis</p>
-----------------------------	--

Yogyakarta, 14 Mei 2020

Reviewer 1/2 *



Nama : Prof. Dr. Heru Kuswanto, M.Si
NIP : 196111121987021001
Bidang Ilmu : Fisika
Jabatan Akademik : Guru Besar
Unit Kerja : FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta